

アナログ・デバイスズ 2026卒向け 夏のインターンシッププログラム

時期：2024年8～9月（実施日は部署により異なる）

場所：ADI Japan オフィス（東京・大阪）

時間：5時間程度（最大一日7.5時間）

報酬：時給1200円（実務時間に限る）

対象者：東京オフィスあるいは大阪オフィスに通勤可能な方

*今回は首都圏あるいは大阪近郊在住学生を想定していますが、
夏休み期間帰省している実家から通勤が可能が学生も応募可能といたします

インターンシップ契約書および機密保持契約書を交わしていただきます

2026卒向け 夏のインターンシッププログラム

INDUSTRIAL AUTOMATION

実施時期	8月19日～23日
受入人数 (max)	5名
実施内容	アナログICの評価
参加条件	電子回路の知識、ラボワークが好きな方、やる気があること

INDUSTRIAL INSTRUMENTATION

実施時期	8月5日～8月9日
受入人数 (max)	2名
実施内容	マイクロ波回路向けクロック生成ICの特性評価
参加条件	専攻・専門は問わず、ただし、電子計測器（オシロスコープ・スペクトラムアナライザなど）の使用経験のある方

2026卒向け 夏のインターンシッププログラム

INDUSTRIAL ECOSYSTEM

実施時期	8月5日～9日 あるいは8月26日～30日
受入人数 (max)	1名ずつ
実施内容	ROSを利用した自律移動ロボットの デモ機開発
参加条件	ROSのプログラミング経験者

INDUSTRIAL POWER

実施時期	8月中の10日間（お盆期間は除く）
受入人数 (max)	1名
実施内容	製品紹介デモンストレーションシス テムの設計
参加条件	回路図設計からの電子工作経験者、 専攻問わず。電源回路に興味があると 尚良し

2026卒向け 夏のインターンシッププログラム

DIGITAL INFRASTRUCTURE CONSUMER

実施時期	8月26日～30日
受入人数 (max)	3名
実施内容	コンシューマー製品の分解調査・ デモキットの作成
参加条件	理系全般

DIGITAL INFRASTRUCTURE HEALTHCARE

実施時期	9月2日～6日 あるいは9月9日～13日
受入人数 (max)	2名
実施内容	Field Application Engineer (FAE) 職の実体 験。担当して頂く Application は Healthcare 領 域になります。
参加条件	将来FAE職を希望している方 分野を問わず技術系職に興味がある方 オシロスコープ・電源等の測定器の使用 経験がある方

2026卒向け 夏のインターンシッププログラム

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL BUSINESS

実施時期	9月2日～6日 あるいは9月17日～20日
受入人数 (max)	3名
実施内容	ラボワーク・製品の分解および市場調査 (デジタルビジネス部門がみる市場の中の ヘルスケア医療機器、通信)
参加条件	電気電子・物理・情報専攻

2026卒向け 夏のインターンシッププログラム

AUTOMOTIVE @TOKYO

実施時期	8月・9月の3~4週間
受入人数 (max)	1名
実施内容	イーサネットICの評価キットを使ったデモソフトウェアの作成
参加条件	組み込みSWに強い興味のある学生、C言語でのプログラミング経験がある学生

AUTOMOTIVE @OSAKA

実施時期	8月・9月の3~4週間
受入人数 (max)	1名
実施内容	自動車向け高速データ伝送技術 (SerDes) ICに係る計測・データ取り、特性評価
参加条件	大阪オフィスに勤務可能な方 自動車向け高速データ伝送技術 (SerDes) ICに興味がある学生。電気電子回路工作経験者